联络人
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204
ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2019 年第一季自结财务报告

2019 年 4 月 25 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(25)日公告 2019 年第一季自结财务报告。

2019 年第一季财务概况

- 本季合并营收新台币 36.19 亿元，较前季减少 14%，较去年同期减少 19%
- 本季合并毛利率为 25.0%，较前季减少 7.6 个百分点；
  本季营业净利率 8.3%，较前季减少 10.4 个百分点
- 本季营业净利为新台币 3 亿元，较前季减少 62%，较去年同期减少 71%
- 本季税后净利为新台币 1.51 亿元，较前季及去年同期均减少 79%；
  每股盈余为新台币 0.41 元，前季为新台币 1.8 元

2019 年第二季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 预计第二季营收将较第一季成长 mid-teens 百分比。
- 预计第二季毛利率预计约为 low thirties 的水平。

管理者评论

"2019年第一季在面临产业传统淡季及终端需求不振的影响之下，营收为新台币36.19亿元，季成长率及年成长率分别为 -14%及 -19%，产能利用率大约是在5成的水平，在产品组合未有明显进步的情况之下，毛利率也如预期的在25%附近。营业费用则因研发及销售费用略为提升而季增 3%，第一季营业净利率亦因此下滑到 8.3%，我们认为淡季营收明显下滑而导致第一季费用率攀高应属短期现象。

回顾上一季法说会时，我们对于5G及3D感测将成为稳懋未来成长动能充满信心的同时，我们也对于2019年短期所要面对的挑战提出我们的看法。虽然我们提到，普遍认为5G的发展在 2019年仍属于初期的阶段，不过，我们的确观察到关于基础建设的应用，相关客户有更积极的5G开发项目及先期量产订单，在第一季较为低迷的淡季中成为业绩仍能同时维持季成长及年成长的产品族群。另外，在农历年后我们陆陆续续看到来自亚洲的智能型手机相关PA设计公司客户增加了投片量，让三月的业绩有了显著的提升，推升了第一季的营收略优于原先的预期，我们认为第一季应是今年营运的谷底，对于2019年全年展望具有相当的信心。

展望2019年第二季，预计营收将较第一季成长mid-teens百分比，预期毛利率约为low thirties的水平。"

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。